



# 第7回研究会

## 3 DHIアライアンス第7回研究会 - Chiplet材料技術新動向（特に微細RDL材料を中心に） -

- 12:45 開場
- 13:00 ~ 13:45 「後工程向け塗布現像装置の取り組みと戦略」  
東京エレクトロン株式会社 CTSPSBU クリーントラックマーケティング部  
スペシャリスト 土屋 勝裕 氏
- 13:45 ~ 14:30 「先端半導体パッケージに向けたフォトレジストと機能性ケミカルの展開」  
住友化学株式会社 ICT&モビリティソリューション業務室  
安藤 信雄 氏
- 14:30 ~ 15:15 「未来のAI向け半導体パッケージを支えるマスクレス露光技術」  
株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ  
フロンティア技術統轄部 露光プロダクト部  
中塚 篤志 氏
- 15:15 ~ 15:30 休憩
- 15:30 ~ 16:15 「ポリイミドを中心とした後工程材料技術」  
東レ株式会社 電子情報材料研究所 主任研究員  
荒木 斉 氏
- 16:15 ~ 17:00 「次世代チップレット開発・微細RDL開発UPDATE」  
大阪公立大学 客員教授  
笹子 勝 氏
- 17:00 ~ 17:15 「来年度にむけてのご連絡」  
3 DHI事務局
- 17:15 ~ 18:15 「名刺交換会（会場のみ\*）」 \*スナック菓子とアルコール類を用意しています。